

# SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 V1.7

Page: 1/16本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术档。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 No.: TDDS01-S7101-CN(B) Version: V1.7

### SQ7101/SQ7103, Secure ASIC, AES-128/AES-256, SHA-256, TRNG

#### 基本信息:

工作电压范围: 2.0V~5.5V

工作温度范围: -40℃~85℃

#### 低功耗平台

- 低功耗设计支持运作(operation)与深眠 (Deep Sleep)模式
- 深眠模式功耗250nA

#### 安全加密防护功能:

- AES-128/AES-256硬件加解密算法
- SHA-256硬件哈希算法
- 真随机数生成器(true random number generator, TRNG)
- 物理上使用强力密封和篡改检测电路,在侦 测到侵入企图时, 立即清除密钥和敏感数据
- 差分功耗分析旁路攻击保护(SPA/DPA: simple/differential power analysis)
- 独立的内部时钟、可防止外部Glitch攻击
- 128位唯一识别码 (UID)
- **NIST CAVP Certification**
- 支持16个128-bit 或8个256-bit 密钥
- 256 Bytes 用户数据(User Data)
- 768 Bytes Small Zone
- 内建 16个monotonic 计数器、防止replay 攻击 及中间人(man in the middle)攻击

#### 封装形式:





SOP8

8Lead-DFN(3x3)

#### 通讯接口

- SO7101 具I2C接口(最高传输速度 400Kbps)、接口线少,控制方式简单、容 易将加密功能整合到现有设计中
- SO7103 具SPI接口(最高传输速度5MHz)

#### 应用项目:

- 配件认证、耗材认证
- 系统反仿冒
- 加密电子锁、指纹锁
- 对话密钥交换 (Session Key Exchange)
- 连网装置安全识别或认证
- 敏感数据加密
- 上位机软件、版权保护
- 崁入式系统韧体(Firmware)保护
- 安全链路、安全控制

### iMQ Technology Inc.

Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 No.: TDDS01-S7101-CN(B) Version: V1.7

#### 目录

1.产品简介	
1.1 重点说明	4
2. 引脚配置	
2.1 SQ7101 引脚配置/说明	5
2.2 SQ7103 引脚配置/说明	6
3. 电气特性	7
3.1 极限参数	7
3.2 工作条件	7
3.2.1 工作条件	7
3.2.2 I/O 特性	7
3.3 DC 特性	
3.4 上电复位电气特性	8
3.5 BROR 电气特性	9
3.6 AC 特性	
3.6.1 运行模式时序特性	9
3.6.2 I2C 特性	
3.6.3 SPI 特性	
3.7 EEPROM 特性	13
附录 A. 封装信息	14
修改记录	16

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7

### 1.产品简介

### 1.1 重点说明

SQ7101/SQ7103 为一高安全性、低功耗之加密芯片,支持 16 个 128-bit 或 8 个 256-bit 密钥,具有真随机数 生成器,以硬件实现 AES-128/AES-256 加密运算法、SHA-256 哈希算法,具备侦测环境攻击防护等功能大幅提 升加密安全性。具标准 I2C 通信接口,易于整合到原有的设计中,进行产品安全升级。

SQ7101/SQ7103 加密芯片适用于配件/耗材认证、系统反仿冒、加密电子锁、指纹锁、对话密钥交换 (Session Key Exchange)、连网装置安全识别或认证、敏感数据加密、...等高安全性的应用需求。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7

# 2. 引脚配置

# 2.1 SQ7101 引脚配置/说明

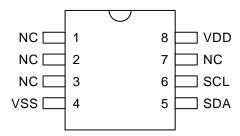


图 2-1 SQ7101 SOP8 封装型态引脚配置

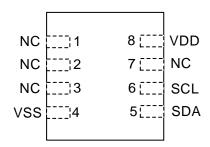


图 2-2 SQ7101 8L-DFN 封装型态引脚配置

引脚编号	引脚名称与 端口/选择功能	输入输出I/O类型			
1	NC	ı	不连接		
2	NC	1	不连接		
3	NC	-	不连接		
4	VSS	GND	接地		
5	SDA	I/O	I2C总线,串行数据输入/输出引脚		
6	SCL	1	I2C总线,串行时钟输入引脚		
7	NC	ı	不连接		
8	VDD	电源	VDD电源输入		

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7

# 2.2 SQ7103 引脚配置/说明

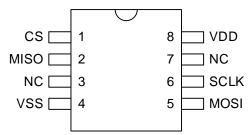


图 2-3 SO7103 SOP8 封装型态引脚配置

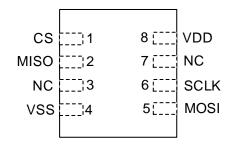


图 2-4 SO7103 8L-DFN 封装型态引脚配置

引脚编号	引脚名称与 端口/选择功能		输入输出I/O类型
1	CS	I	SPI,芯片选择引脚
2	MISO	0	主设备输入/从设备输出引脚
3	NC	-	不连接
4	VSS	GND	接地
5	MOSI	I	SPI,主设备输出/从设备输入引脚
6	SCLK	I	SPI,串行时钟输入引脚
7	NC	-	不连接
8	VDD	电源	VDD电源输入

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7

# 3. 电气特性

### 3.1 极限参数

单片机操作时切勿超过以下任一项极限参数值。即使仅是极短时间,也可能造成单片机损坏或性能衰退, 严重者可能导致起火或爆炸、造成伤害。因此,请确保采用本单片机设计开发之产品 或系统不超过以下极 限参数值。

 $(V_{SS} = 0V)$ 

参数	符号	引脚	极限参数	单位
工作电压范围	$V_{DD}$		-0.3 to 6.0	V
输入电压范围	V <sub>IN</sub>	全部 I/O 引脚	-0.3 to VDD+0.3V	V
最大输出电流	I <sub>OL</sub>	全部 I/O 引脚	50	mA
保存温度范围	T <sub>STG</sub>		-50 to 125	°C

### 3.2 工作条件

以下定义出当装置于「电压及温度最大/最小值」运行时其电气特性。「标准」条件是在「室温 25℃及标 准工作电压 VDD=3.3V 」下测定而得。

若有不同于以上定义或是更详细的工作条件,会于各表格中的「测试条件」字段中注明该条件。

#### 3.2.1 工作条件

参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
工作电压	$V_{DD}$		2.0	3.3	5.5	V
工作温度	Та		-40	25	85	°C

### 3.2.2 I/O 特性

参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
低电压输入	$V_{IL}$		0		0.3 VDD	V
高电压输入	V <sub>IH</sub>		0.7 VDD		VDD	V
端口引脚之低电压输出	V <sub>OL</sub>	IOL= 3 mA	0		0.1VDD	V
端口引脚之高电压输出	V <sub>OH</sub>	IOH= -3 mA	0.9VDD		VDD	V

**Page: 7/16**本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术档。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7

### 3.3 DC 特性

参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
运作模式 (Operation)	I <sub>DD_N1</sub>	VDD=3.3V, Temp=25 °C		3		mA
深眠模式 (Deep Sleep)	I <sub>DD_DS</sub>	VDD=3.3V, Temp=25 °C		250		nA

### 3.4 上电复位电气特性

	Ta=-40~85°					
符号	叙述	最小	标准	最大	单位	
tPPW	上电复位最小脉宽 Power-on reset minimum pulse width	1	-	-	ms	
tPWUP	上电复位后到 CPU ready 时间 Warming-up time after a reset is clear and CPU ready	-	4	-	ms	
tVDD	上电时间 Power supply rise time	0.5		5	ms	

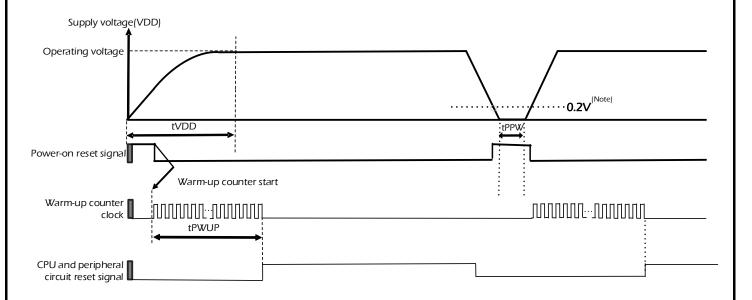


图 3-1 上电复位时序图

Note: 当系统下电时, 电压需低到 0.2V 再重新上电, 才能确保重新上电后的 IC 动作正常。

**Page:8/16** 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术档。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7

### 3.5 BROR 电气特性

Ta=-40~85°C						40~85°C
参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
BROR 检测电压	VBROR_Rising	VDD rise time and fall time > tVDD	1 95	2.0	2.05	V
	VBROR_Falling	(tVDD please refer to <u>Ch3.4 上电复</u> 位电气特性)	1.85	1.90	1.95	V

### 3.6 AC 特性

参数	符号	测试条件	最小	标准	最大	单位
用户数据更新时间						
(User Data Write Cycle	Twc <sub>1</sub>		6.0	-	9.0	mS
Time) (注)						
128-bit 密钥更新时间						
(Key Write Cycle Time)	Twc <sub>2</sub>		6.0		9.0	mS
(注)						

注: Writer cycle time 包含数据更新以及自动检验之运作

### 3.6.1 运行模式时序特性

参数	符号	最小	标准	最大	单位
上電後就緒時間	т		1200 <sup>(注</sup> //	1500	uS
Power-Up Ready Time	$T_{PU\_RDY}$		1200(- //	1500	us
Standby 時間・進入 deep sleep 模式	т		EE	00	C
Standby Time, Entering the deep sleep mode	$T_{STB}$		55	90	uS
喚醒就緒時間·deep sleep 模式	Tier		300		C
Wake-Up Ready Time, deep sleep mode	$TW_{DS\_RDY}$		300	=	uS

注1: 上電後就緒時間不包含BOOTROM code 执行时间; BOOTROM code 执行时间约需10ms。

注2: 标准值为室温25℃之参考值。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7

### 3.6.2 I2C 特性

参数	符号	最小	最大	单位
SCL 时钟频率 (clock frequency)	f <sub>SCL</sub>	0	400	kHz
重启条件保持时间 (hold time repeated START condition) 第一个时钟脉冲产生跟随在此时间之后发生。	t <sub>HD;STA</sub>	0.6	-	us
SCL 时钟低电平周期 (low period of SCL clock)	t <sub>LOW</sub>	1.3	-	us
SCL 时钟高电平周期 (high period of SCL clock)	t <sub>HIGH</sub>	0.6	-	us
重启条件设置时间 (setup time for a repeated START condition)	t <sub>su;sta</sub>	0.6	-	us
数据保持时间 (data hold time)	t <sub>HD;DAT</sub>	0	0.8	us
数据设置时间 (data setup time)	t <sub>su;DAT</sub>	0.1	-	us
SDA 与 SCL 上升时间 (rise time of both SDA and SCL)	t <sub>r</sub>	20	300	ns
SDA 与 SCL 下降时间 (fall time of both SDA and SCL)	t <sub>f</sub>	20	300	ns
停止条件设置时间 (setup time of STOP condition)	t <sub>su;sto</sub>	0.6	-	us
停止条件与开始条件间的总线自由时间 (bus free time between a STOP and START condition)	t <sub>BUF</sub>	1.3	-	us
每条总线之电容负载(capacitive load for each bus line)	C <sub>b</sub>	-	400	pF
注:以上为特性值,非经生产测试。			1	ı

表 3-1 I2C AC 规格

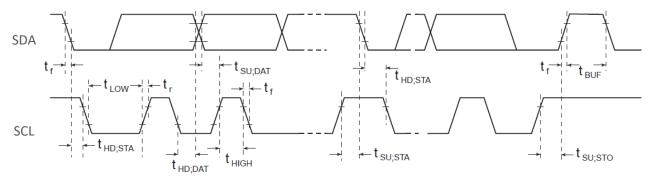


图 3-2 I2C 时序图

Page: 10/16 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术档。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7

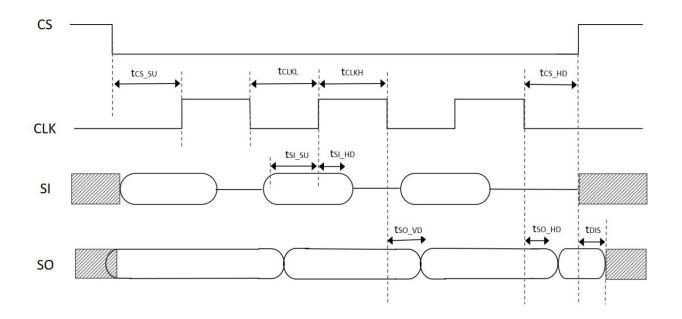
### 3.6.3 SPI 特性

参数	符号	最小	最大	单位
SPI 频率	f <sub>SPI</sub>		5	MHz
(SPI Frequency)	-311			
SPI 周期	tspi	200		ns
(SPI Period)	4311			
SCLK 高电平周期	tсікн	90		ns
(High period of the SCLK pin)	CLKH	,,		113
SCLK 低电平周期	t <sub>CLKL</sub>	90		ns
(Low period of the SCLK pin)	CLKL	70		113
从 SPICS 有效到第一个边沿的时间	t <sub>CS SU</sub>	40		ns
(From SPICS active to first edge)	rC2_20	10		113
从最后一个 SCLK 边沿到 SPICS 无效的时间	t <sub>CS HD</sub>	40		ns
(From last SCLK edge to SPICS inactive)	rC7_HD	40		113
SPI 传输时间	SPI 传输时间			us
(Time between SPI transaction)	t <sub>CS_WA</sub>	1		us
输入数据设置时间				ns
(Data Input Setup Time)	t <sub>si_su</sub>	10		113
输入数据保持时间	t	10		ns
(Data Input Hold time)	t <sub>SI_HD</sub>			113
输出数据有效时间	+		80	nc
(Data Output Valid Time)	t <sub>so_vd</sub>		60	ns
输出数据保持时间	+			ns
(Data Output Hold Time)	t <sub>so_HD</sub>	0		115

表 3-2 SPI AC 规格

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7



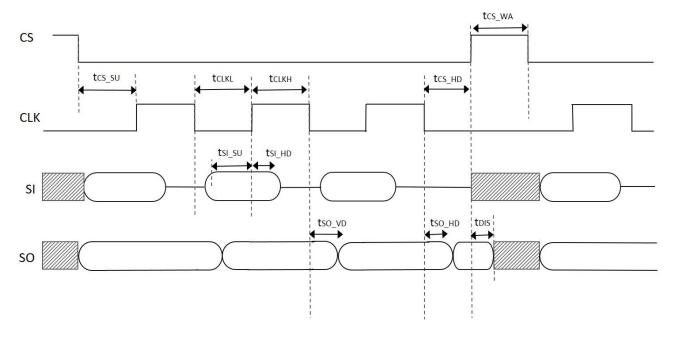


图 3-3 SPI 时序图

Page: 12/16 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术档。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7

### 3.7 EEPROM 特性

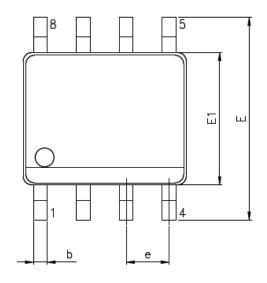
参数	最小	标准	最大	单位
Write Endurance (Sector Endurance)	100,000	-	-	Cycles
Data Retention( at 25°C)	100	-	-	Years
Data Retention( at 85°C)	20	-	-	Years

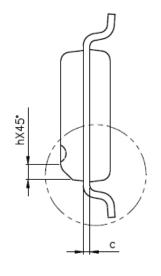
iMQ Technology Inc.

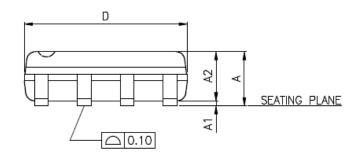
No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7

# 附录 A. 封装信息

SOP8





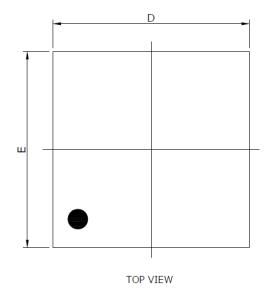


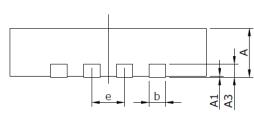
1# D.E	毫米			
標號	最小值		最大值	
Α	-	ı	1.75	
A1	0.10	_	0.25	
A2	1.25	_	_	
b	0.31	ı	0.51	
С	0.10	_	0.25	
D	4.90 BSC			
Е	6.00 BSC			
E1	3.90 BSC			
e	1.27 BSC			
L	0.40	ı	1.27	
L1	1.00 REF			
h	0.25	-	0.50	
θ	0 °	_	8 °	

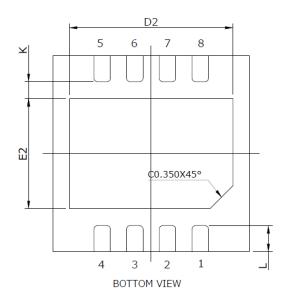
iMQ Technology Inc.

Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 No.: TDDS01-S7101-CN(B) Version: V1.7

### 8L DFN (3x3)







標號	毫米			
	最小值		最大值	
Α	0.70	0.75	0.80	
A1	0.00	0.02	0.05	
А3	0.203 REF.			
b	0.20	0.25	0.30	
D	2.90	3.00	3.10	
E	2.90	3.00	3.10	
е	0.50 BSC			
L	0.35	0.40	0.45	
D2	2.45	2.50	2.55	
E2	1.63	1.68	1.73	
К	0.20	_	_	

Page: 15/16 本出版物内容版权为汉芝电子所有,非经汉芝电子书面同意,不得变更内容及使用,汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益,恕不另行通知。购买汉芝电子产品前,请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术档。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害之相关领域,汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。

iMQ Technology Inc.

No.: TDDS01-S7101-CN(B) Name: SQ7101/SQ7103 简要中文产品规格书 Version: V1.7

# 修改记录

版本	发布日期	改版描述
		1. 修正工作电压范围 2.0~5.5V;修正"3.1 极限参数"与"3.2.1 工作条件 "的
		工作电压范围
		2. 更新图 3-1 上电复位时序图与注"当系统下电时,电压需低到 0.2 V 再重新
V1.7	2023/4/20	上电·才能确保重新上电后的 IC 动作正常"
V 1.7	2023/ 1/20	3. "3.6.1 运行模式时序特性",新增注1:"上电后就绪时间不包含BOOTROM
		code 执行时间;BOOTROM code 执行时间约需10ms。
		4. "3.6.2 I2C特性"新增t <sub>HD;DAT</sub> 数值
		5. 图 3-2 I2C 时序图, 新增 SDA, SCL 标示
V1.6	2022/11/3	1. 修正「3.4 上电复位电气特性」图 3-1 上电复位时序图与其备注
V1.5	2022/7/21	1.「Small Zone 修改为 768 Bytes」
V 1.5	2022/1/21	2. 「2.1 SQ7101 引脚配置/说明」与「附录 A 封装信息」新增 8L DFN 3x3
V1 4	V1.4 2021/12/29	1. 修改 「上电复位时序图」
V 1. 1		2. 新增 「CH3.5. BROR 电气特性」
V1.3	2021/11/30	1. 调整章节顺序
V 1.5	2021/11/30	2. 新增「CH3.4.上电复位电气特性」
V1.2	2021/6/24	1. 新增「CH3.7. EEPROM 特性」说明。」
V1.1	2020/12/30	1. 新增 SQ7103 机种相关叙述、「CH2.2 SQ7103 引脚配置/说明」、
V 1.1	2020/12/30	「CH3.6.3 SPI 特性」
V1.0	2020/9/1	1. 首次发行